トーカロ株式会社

2026 年 3 月期 第 2 四半期決算 会社説明会

2025 年 11 月 13 日

イベント概要

[企業名]	トーカロ株式会社
[企業 ID]	3433
[イベント言語]	JPN
[イベント種類]	決算説明会
[イベント名]	2026 年 3 月期 第 2 四半期決算 会社説明会
[決算期]	2025 年度　第 2 四半期
[日程]	2025 年 11 月 13 日
[ページ数]	41
[時間]	13:30 – 14:12 （合計：42 分、登壇：20 分、質疑応答：22 分）
[開催場所]	インターネット配信
[会場面積]	
[出席人数]	
[登壇者]	4 名

代表取締役 社長執行役員	小林　和也（以下、小林）
取締役 専務執行役員 管理本部長	後藤　浩志（以下、後藤）
執行役員 経営企画部長	中井　勝紀（以下、中井）

	経営企画部 専門課長	真砂　綾　（以下、真砂）
[アナリスト名]*	いちよし経済研究所	大澤　充周

*質疑応答の中で発言をしたアナリスト、または質問が代読されたアナリストの中で、SCRIPTS Asia が特定出来たものに限る

登壇

司会：お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまからトーカロ株式会社様の 2026 年 3 月期第 2 四半期の決算説明会を開催いたします。

本日の説明会は会場での開催に加えまして、ライブ配信形式のオンラインと合わせましたハイブリッド形式で開催いたします。それではまず初めに、会社からお迎えしている 4 名様、ご紹介申し上げます。

まず、代表取締役社長、執行役員の小林和也様。

小林：よろしくお願いします。

司会：ありがとうございます。取締役常務執行役員、管理本部長の後藤浩志様。

後藤：後藤でございます。よろしくお願いします。

司会：執行役員、経営企画部長の中井勝紀様。

中井：中井でございます。よろしくお願いします。

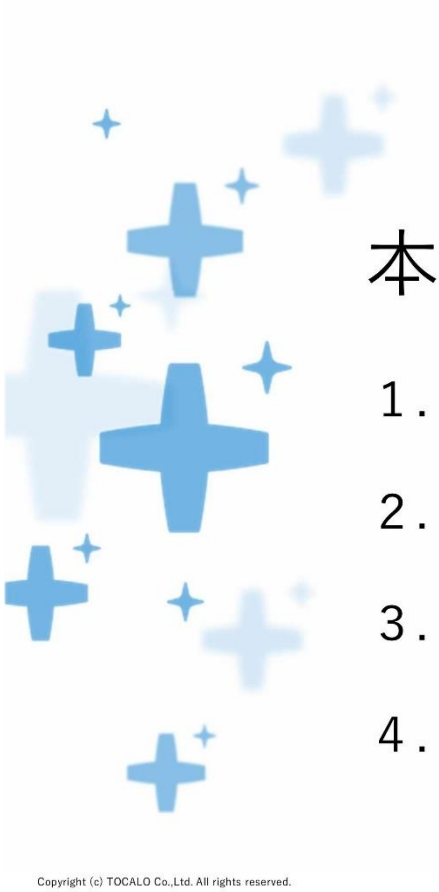
司会：経営企画部、専門課長の真砂綾様。

真砂：真砂でございます。よろしくお願いします。

司会：どうもありがとうございます。本日ご説明は、小林社長様からいただくことになっております。

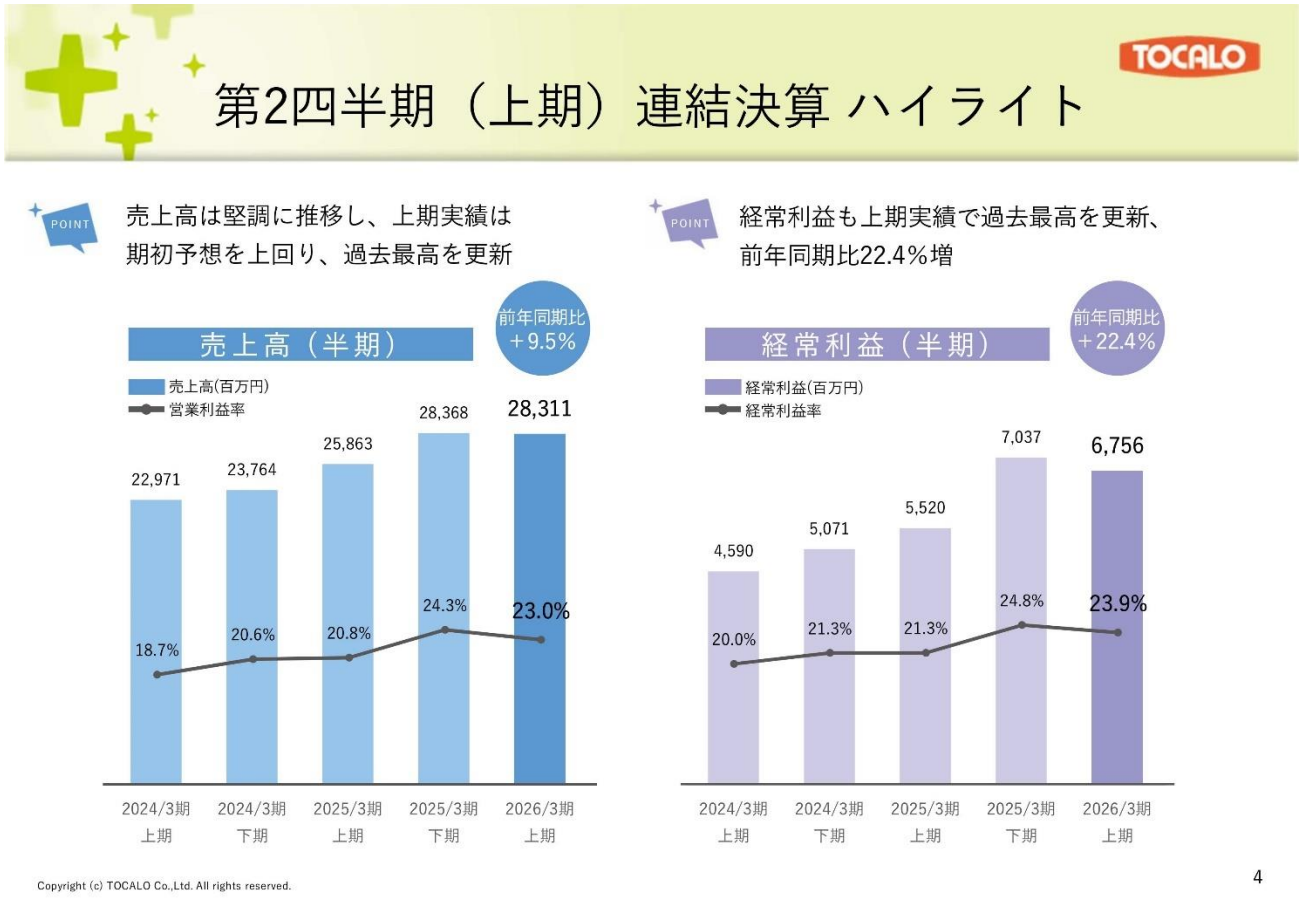
ご説明の後、まずは会場からの質疑応答の時間としまして、続きましてオンライン参加されている方のご質問をお受けします。オンライン参加の方、ご質問は会社名、お名前をご入力のうえ、Q&A 機能でご質問ください。質問は説明中でも受け付けています。

それでは小林様、よろしくお願いいたします。



小林：皆さん、こんにちは。社長の小林です。よろしくお願いします。本日はご多用の中、トーカロ株式会社の決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日は、リアルとライブ中継を合わせて、80 名近い皆様にご参加いただいているようです。よろしくお願い申し上げます。

本日ご説明する内容は、この四つでございます。



まず、2026 年 3 月期上期の決算概要をご説明します。

半期ベースの実績を、過去 4 四半期と比較したグラフです。左が売上高と営業利益率、右が経常利益と経常利益率です。当期の上期実績は売上高 283 億円、経常利益 67 億円、経常利益率 23.9%と、売上高、経常利益ともに期初予想を上回り、上期実績としては過去最高を更新しております。

2026年3月期 第2四半期（上期）連結決算の概要

- 売上高は好調に推移し、前年同期比9.5%増
- 経常利益も、上期計画通り好調に推移し、前年同期比22.4%増

（百万円）	2025/3期　上期		2026/3期　上期		前年同期比増減	
	実　績	構成比	実　績	構成比	金　額	率
売上高	25,863	100.0%	28,311	100.0%	2,448	9.5%
営業利益	5,383	20.8%	6,518	23.0%	1,135	21.1%
経常利益	5,520	21.3%	6,756	23.9%	1,235	22.4%
親会社株主に帰属する中間純利益	3,556	13.8%	4,427	15.6%	871	24.5%
1株当たり中間純利益（EPS）	59.83円	―	74.46円	―	14.63円	―

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

売上利益について、前年度上期との比較表をご参考にお示ししておきます。

サポート

日本　　050-5212-7790

フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス　support@scriptsasia.com

SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

2026年3月期 第2四半期（上期）売上高(分野別)

- 最大セグメントの溶射加工(単体)は、半導体・FPD、産業機械が好調に推移し、前年同期比3.3%増
- その他表面処理加工は、農業機械部品向けで顧客の在庫調整があり、前年同期比11.1%減
- 海外子会社は、半導体および鉄鋼関連を中心に好調に推移し、前年同期比45.2%増

（百万円）	2025/3期 上期		2026/3期 上期		前年同期比増減	
	実 績	構成比	実 績	構成比	金 額	率
売上高	25,863	100.0%	28,311	100.0%	2,448	9.5%
溶射加工(単体)	19,325	74.7%	19,961	70.5%	635	3.3%
半導体・ＦＰＤ	11,395	44.1%	11,989	42.4%	594	5.2%
産業機械	2,370	9.2%	2,655	9.4%	285	12.0%
鉄鋼	2,029	7.8%	1,974	7.0%	△54	-2.7%
その他	3,530	13.6%	3,341	11.7%	△188	-5.3%
その他表面処理加工	1,381	5.4%	1,228	4.3%	△153	-11.1%
国内子会社	1,191	4.6%	1,409	5.0%	217	18.3%
海外子会社	3,890	15.0%	5,649	20.0%	1,758	45.2%
受取ロイヤリティー等	73	0.3%	62	0.2%	△10	-14.8%

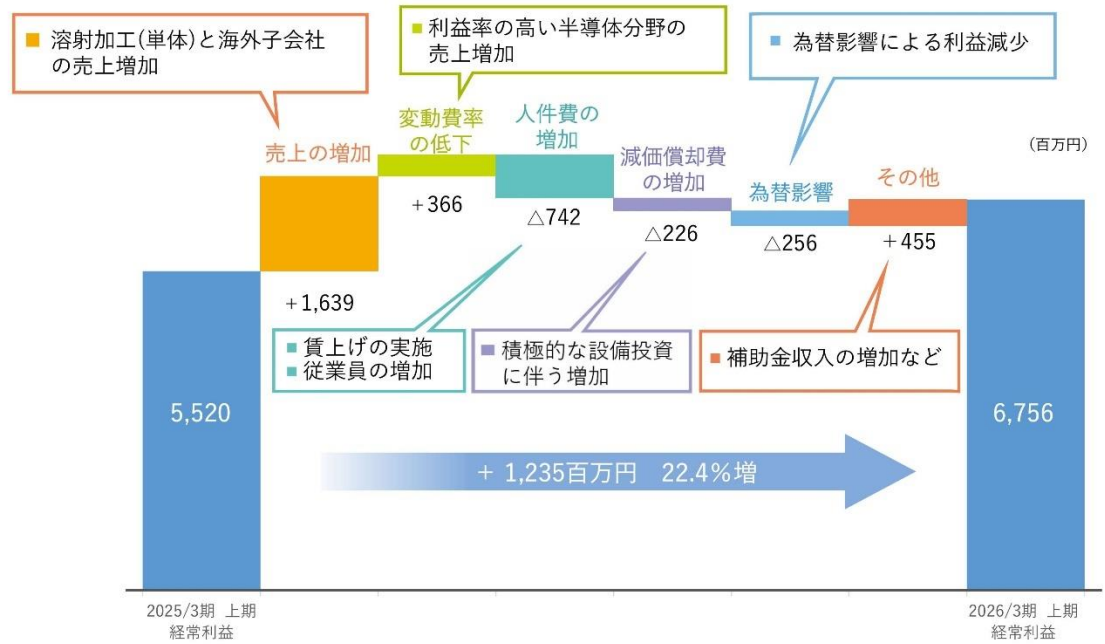
Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

セグメント別の売上高を示した比較表です。

最大セグメントの溶射加工単体は、半導体・FPD 分野、産業機械分野が堅調に推移し、前年同期比 3.3%増となりました。その他、表面処理加工は、農業機械部品向けで顧客の在庫調整が長引いており減収、海外子会社は半導体および鉄鋼関連を中心に好調に推移し、前年同期比 45.2%増でした。

サポート
日本 050-5212-7790
フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

前年同期比 経常利益 増減要因分析

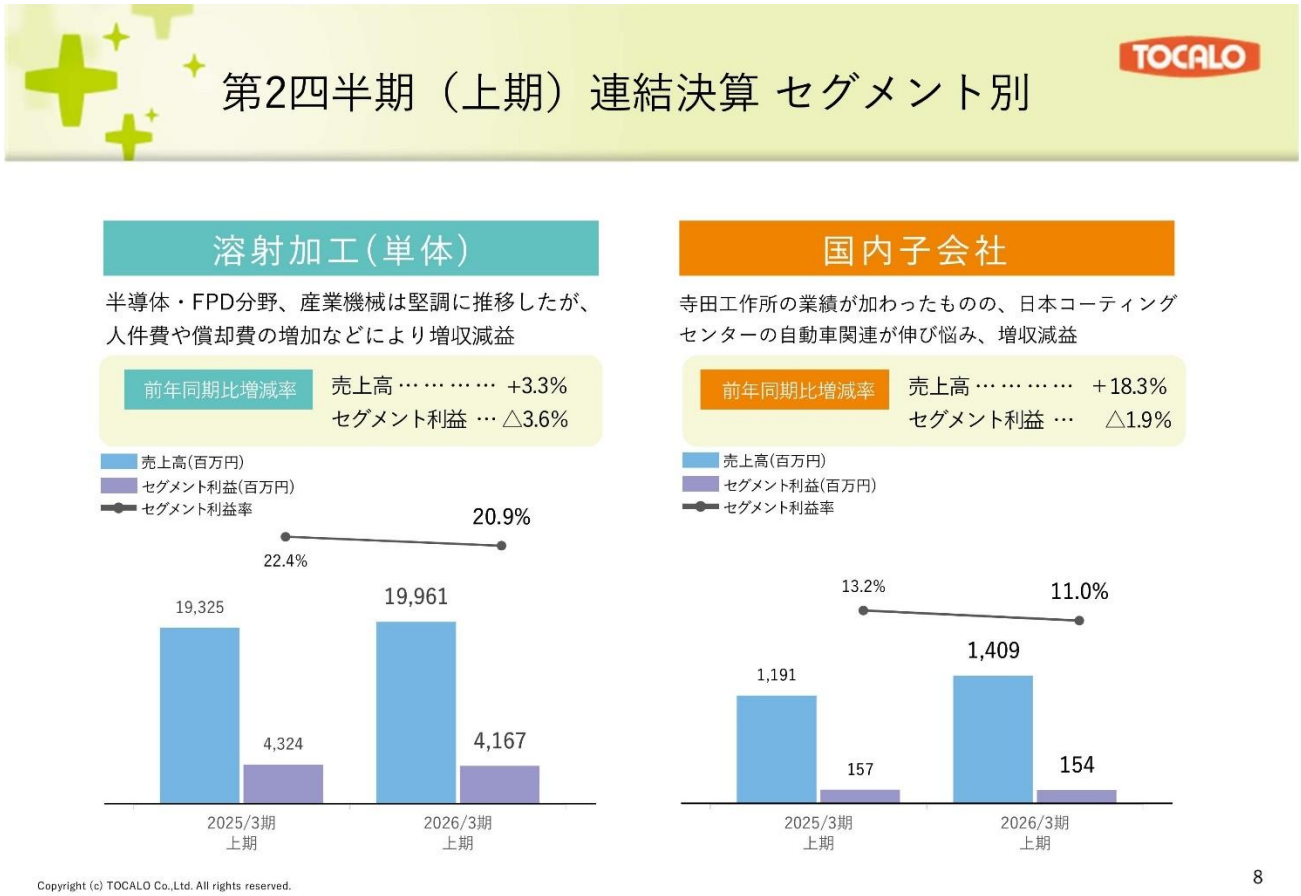


Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

経常利益の前年同期比増減分析です。

当期上期の経常利益は 67 億 5,600 万円と、前年同期比 12 億 3,500 万円増加しましたが、主な増加要因は売上増加と変動費率の低下です。減少要因としては、人件費の増加、為替影響となります。なお、その他の項目には、経済産業省からご支援いただいた賃上げ補助金 2 億 8,300 万円が含まれています。

サポート
日本　　050-5212-7790
フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

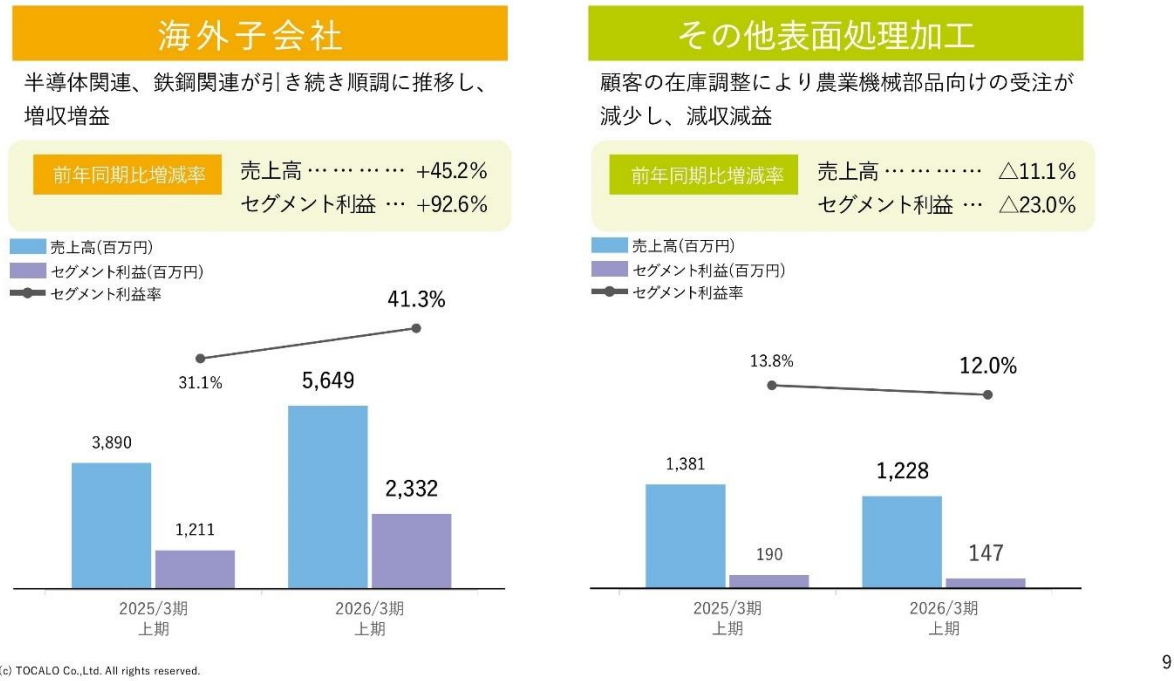


セグメント別の売上利益についてですが、前年同期との比較です。

溶射加工単体は半導体・FPD 分野、産業機械分野が堅調に推移し、増収となりましたが、人件費や償却費の増加により減益となりました。

国内子会社は、昨年 8 月から連結子会社となった寺田工作所の業績が加わったものの、日本コーティングセンターは自動車関連の伸び悩みから減収減益となって、トータルとして増収減益となりました。

第2四半期（上期）連結決算 セグメント別



Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

9

海外子会社は、半導体・鉄鋼関連が順調に推移し、増収増益となりました。その他、表面処理加工は顧客の在庫調整により農業機器部品向けの受注が減少し、減益減収となりました。

セグメント情報

（百万円）	2025/3期　上期		2026/3期　上期		前年同期比増減			
					売上高		セグメント利益	
	売上高	セグメント利益	売上高	セグメント利益	金　額	率	金　額	率
溶射加工(単体)	19,325	4,324	19,961	4,167	635	3.3%	△156	-3.6%
国内子会社	1,191	157	1,409	154	217	18.3%	△3	-1.9%
海外子会社	3,890	1,211	5,649	2,332	1,758	45.2%	1,121	92.6%
その他表面処理加工	1,381	190	1,228	147	△153	-11.1%	△43	-23.0%
合　計	25,789	5,884	28,248	6,802	2,459	9.5%	917	15.6%

(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティー等」は含まれておりません。

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

各セグメントの売上利益について、前年度上期との比較表をご参考にお示ししておきます。

サポート

日本　　050-5212-7790

フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス support@scriptsasia.com

SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

財政状態

- 総資産は、前期末比26億円の増加（有形固定資産：＋34億円）
- 自己資本比率は、前期末比0.1ポイント上昇の74.3%
- 有利子負債は、前期末比6億円の減少

（百万円）	2025/3期		2026/3期
	2Q末	4Q末	2Q末
総資産	77,701	81,683	84,343
自己資本	58,072	60,645	62,645
自己資本比率	74.7%	74.2%	74.3%
有利子負債残高	4,582	3,796	3,191

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

当期第 2 四半期末の財政状況です。

総資産は 843 億円、自己資本は 626 億円、自己資本比率は、利益剰余金が積み上がり、前期末比 0.1 ポイント上昇の 74.3%、有利子負債は新規借入もなく、前期末比 6 億円減少し、31 億円となりました。

サポート
日本　　050-5212-7790
フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

キャッシュ・フローの状況

- 当期のフリーキャッシュ・フロー（営業ＣＦ＋投資ＣＦ）は＋17億円
- 投資ＣＦ／有形固定資産の取得　前期：△28億円　当期：△25億円
  買収・株式取得　前期：△12億円　当期：△ 1億円
- 財務ＣＦ／配当金の支払額　前期：△16億円　当期：△22億円

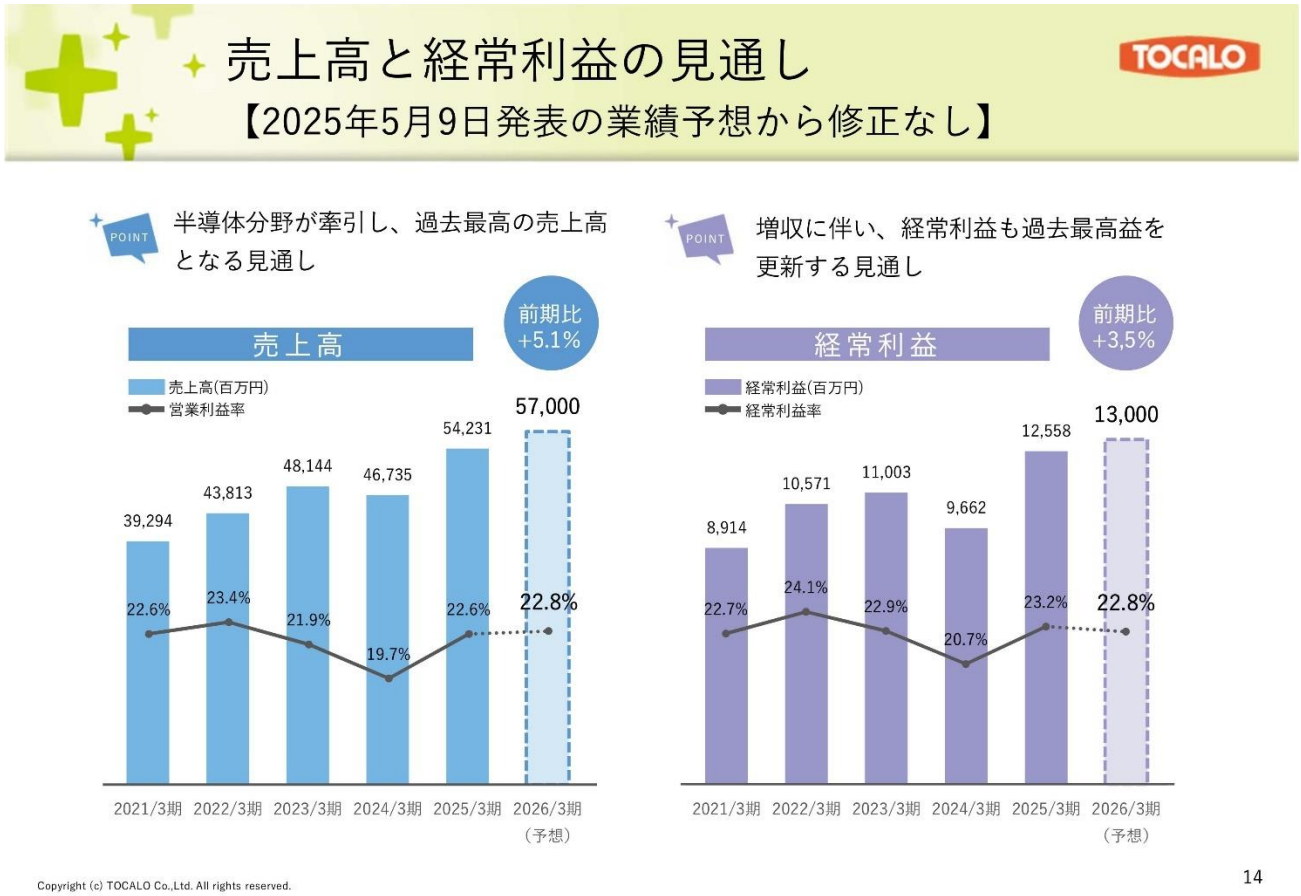
（百万円）	2025/3期 上期	2026/3期 上期
営業キャッシュ・フロー	2,696	4,470
投資キャッシュ・フロー	△ 3,404	△ 2,763
財務キャッシュ・フロー	△ 2,546	△ 3,054
現金及び現金同等物の期末残高	16,594	16,187

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

当期上期のキャッシュ・フローの状況です。

営業キャッシュ・フローがプラス 44 億円、投資キャッシュ・フローはマイナス 27 億円で、フリーキャッシュ・フローはプラス 17 億円と、健全な状況です。財務キャッシュ・フローは、配当および借入返済によりマイナス 30 億円。その結果、当期のキャッシュ残高は、161 億円となりました。

サポート
日本　050-5212-7790
フリーダイアル　0120-966-744　メールアドレス　support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

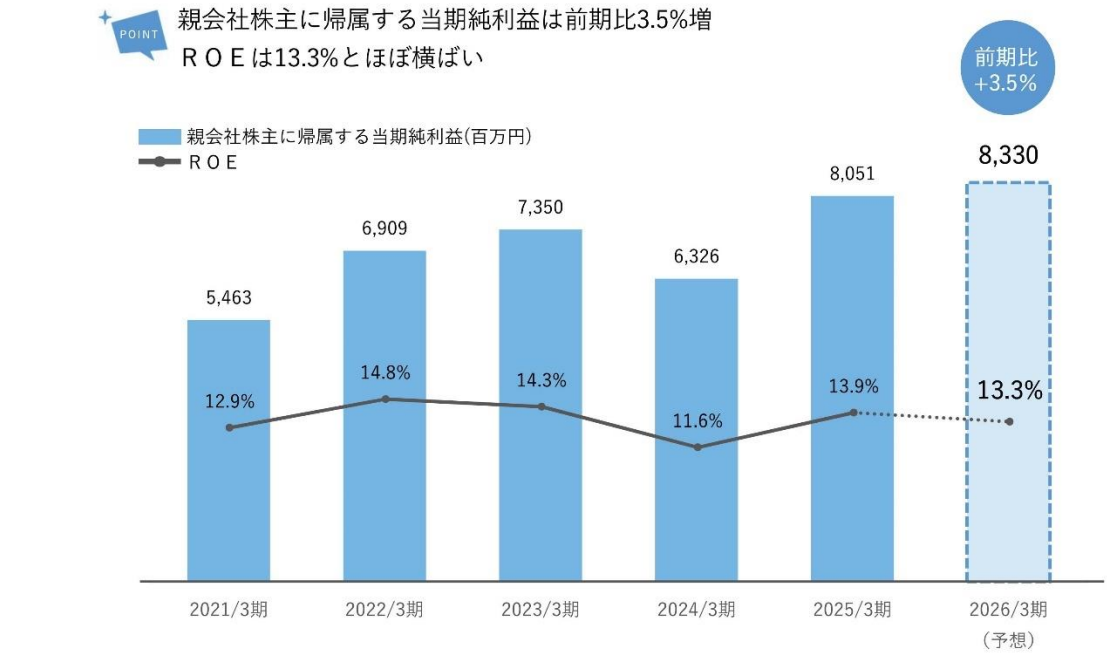


次に、2026 年 3 月期の連結業績予想についてご説明します。

2026 年 3 月期、年間の業績予想は、2025 年 5 月 9 日発表の業績予想から修正はありません。売上 570 億円、経常利益 130 億円、経常利益率 22.8%であります。

売上高は半導体分野が牽引し、過去最高を更新する見通しです。経常利益についても増収に伴い、過去最高益を更新する見通しです。

親会社株主に帰属する当期純利益と ＲＯＥの見通し



Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比 3.5%増の 83 億円となり、ROE は 13.3%と、ほぼ横ばいで推移する見通しです。

サポート
日本　　050-5212-7790
フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス　support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

2026年3月期 連結業績予想

（百万円）	2025/3期　通期		2026/3期　通期		前期実績比増減	
	実　績	構成比	予想	構成比	金額	率
売上高	54,231	100.0%	57,000	100.0%	2,768	5.1%
■ 溶射加工(単体)	39,213	72.3%	39,265	68.9%	51	0.1%
半導体・ＦＰＤ	24,114	44.5%	25,187	44.2%	1,072	4.4%
産業機械	4,872	9.0%	4,338	7.6%	△534	-11.0%
鉄鋼	3,927	7.2%	4,110	7.2%	182	4.6%
その他	6,298	11.6%	5,630	9.9%	△668	-10.6%
■ その他表面処理加工	2,880	5.3%	2,474	4.3%	△406	-14.1%
■ 国内子会社	2,656	4.9%	3,088	5.4%	431	16.3%
■ 海外子会社	9,319	17.2%	12,013	21.1%	2,693	28.9%
受取ロイヤリティー等	161	0.3%	160	0.3%	△1	-0.8%
営業利益	12,268	22.6%	13,000	22.8%	731	6.0%
経常利益	12,558	23.2%	13,000	22.8%	441	3.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	8,051	14.8%	8,330	14.6%	278	3.5%
1株当たり当期純利益（EPS）	135.44円	―	140.08円	―	4.64円	―
自己資本利益率（ROE）	13.9%	―	13.3%	―	-0.6pt	―

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

2026 年 3 月期セグメント別の連結業績予想は、この表のとおりです。

サポート

日本　　050-5212-7790

フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス support@scriptsasia.com

SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

2026年3月期 第2四半期（上期） 進捗率

（百万円）	2026/3期　上期		2026/3期　通期		上期実績進捗率
	実　績	構成比	予想	構成比	
売上高	28,311	100.0%	57,000	100.0%	49.7%
■ 溶射加工(単体)	19,961	70.5%	39,265	68.9%	50.8%
半導体・ＦＰＤ	11,989	42.4%	25,187	44.2%	47.6%
産業機械	2,655	9.4%	4,338	7.6%	61.2%
鉄鋼	1,974	7.0%	4,110	7.2%	48.1%
その他	3,341	11.7%	5,630	9.9%	59.4%
■ その他表面処理加工	1,228	4.3%	2,474	4.3%	49.6%
■ 国内子会社	1,409	5.0%	3,088	5.4%	45.6%
■ 海外子会社	5,649	20.0%	12,013	21.1%	47.0%
受取ロイヤリティー等	62	0.2%	160	0.3%	39.2%
営業利益	6,518	23.0%	13,000	22.8%	50.1%
経常利益	6,756	23.9%	13,000	22.8%	52.0%
親会社株主に帰属する当期(中間)純利益	4,427	15.6%	8,330	14.6%	53.2%
1株当たり当期(中間)純利益（EPS）	74.46円	―	140.08円	―	53.2%

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

通期業績予想に対する上期実績の進捗率です。

売上高の上期進捗率は 49.7%、経常利益については、52.0%となりました。

サポート

日本　　050-5212-7790

フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス　support@scriptsasia.com

SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

半導体・ＦＰＤ分野の売上推移

POINT 上期の売上高は119億89百万円（前年同期比3.3％増）
引き続き、今後の半導体市場の動向を注視していく

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

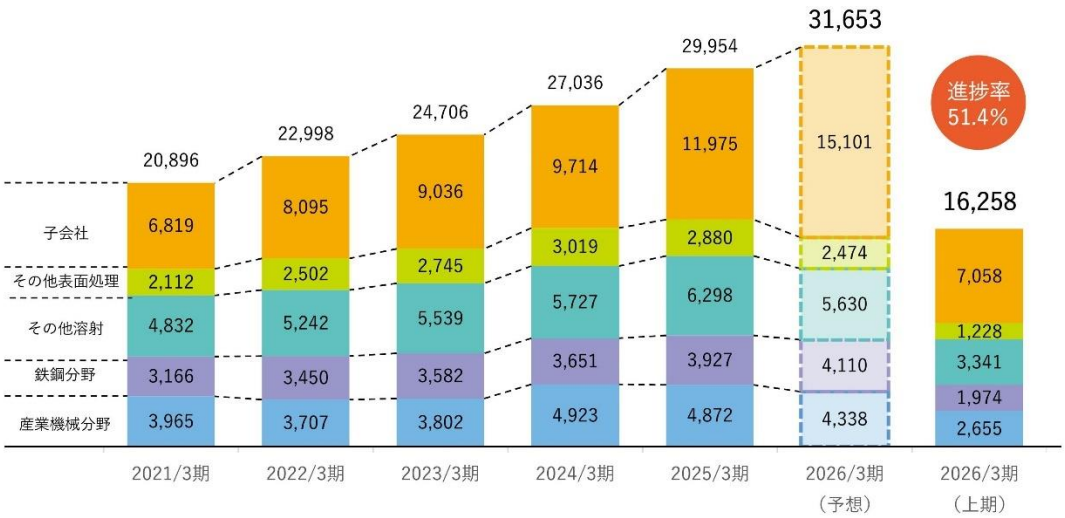
半導体・FPD 分野の売上推移です。

当期の予想は 251 億円、うち半導体が 235 億円、FPD が 15 億円です。この通期予想に対し、上期の売上実績は 119 億円で、進捗率 47.6%となっています。引き続き、今後の半導体市場の動向を注視していきます。

サポート
日本　　050-5212-7790
フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

半導体・ＦＰＤ分野以外の売上推移

POINT
半導体・ＦＰＤ分野以外の売上高は162億58百万円
産業機械分野及び子会社を中心に今後も安定して推移する見通し



(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティー等」は含まれておりません。

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

19

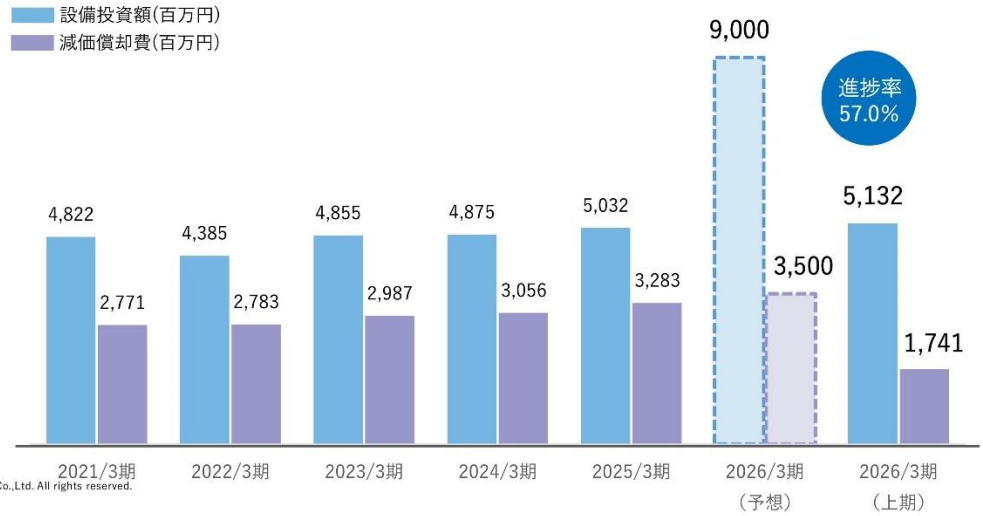
半導体・FPD 分野以外の売上推移です。

当期の予想は 316 億円と、前期の 299 億円から 5.7%の増加を見込んでいます。この通期予想に対し、上期の実績は 162 億円で、進捗率 51.4%となっています。子会社が、順調に成長しています。

設備投資額と減価償却費

POINT 2026年3月期の設備投資予定額　90億円

- トーカロ70億円：東京・北九州工場新棟建設、増産対応・生産効率化、研究設備増強など
- 国内子会社8億円：寺田工作所の新棟建設、日本コーティングセンターの生産能力増強など
- 海外子会社12億円：東賀隆(昆山)・漢泰国際電子(台湾)の新工場立ち上げなど



Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

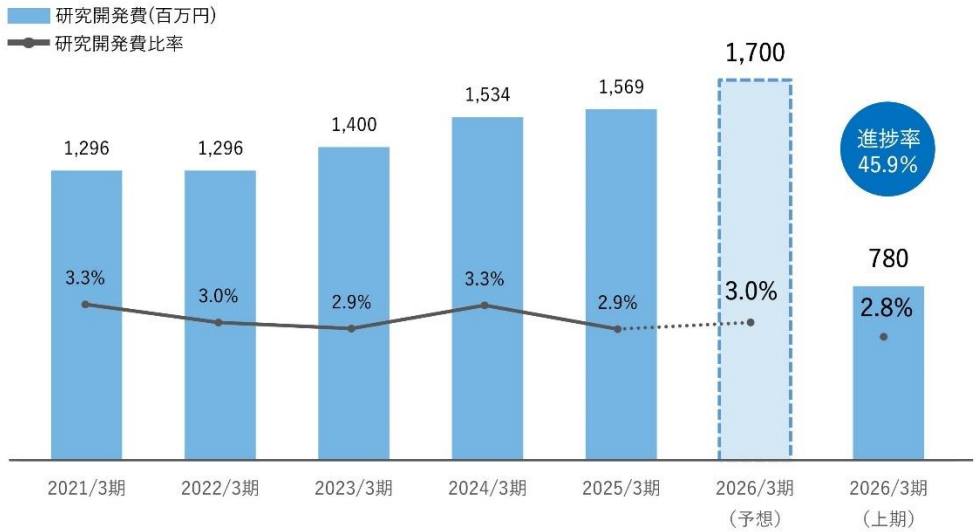
設備投資額と、減価償却費の推移です。

今期の設備投資計画は 90 億円としているところ、上期実績は 51 億円、進捗率 57.0%となりました。主な投資実績としては、東京工場、神戸工場、北九州工場の工場棟建設で 38 億円、海外子会社で 7 億円などであります。

サポート
日本　　050-5212-7790
フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス　support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

研究開発費

POINT 研究開発費は連結売上高比で３％程度を維持



Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

研究開発費の推移です。

当期の研究開発費は 17 億円、売上高比率 3.0%を見込んでいます。この通期予想に対し、上期実績は 7 億 8,000 万円で、進捗率 45.9%となっています。

サポート
日本　　050-5212-7790
フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

2026年3月期 下期予想

POINT 半導体、産業機械関連、海外子会社を中心に堅調な受注が見込まれる

POINT 経常利益も堅調に推移し、通期予想の130億円を達成する見込み

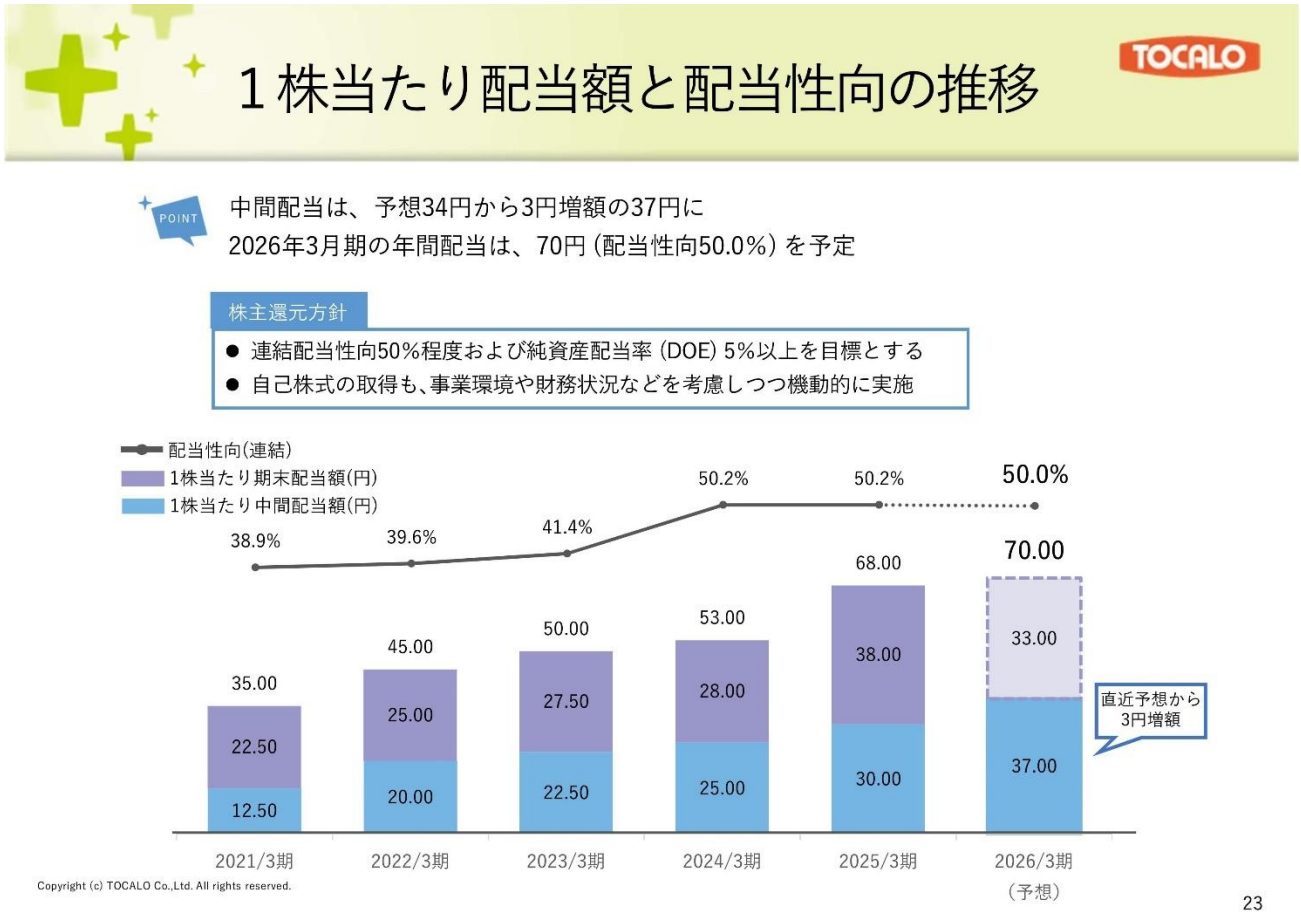
Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

22

2026 年 3 月期下期予想についてご説明します。

これは売上高、経常利益の半期ごとの推移を 3 期間示したグラフですが、現時点では、今期の上期対比で下期は増収減益を予想しています。第 2 四半期で調整があった半導体関連の受注は回復基調にあり、産業機器や海外子会社も、引き続き堅調に推移すると予想しています。

ただ通常、当社の半導体関連の売上は受注に対して遅れて回復してくるので、下期の半導体の売上利益については保守的に捉えています。よって、業績の上積みは十分に期待できると考えています。今後の情報収集により、見直しが必要と判断した場合には速やかに開示いたします。

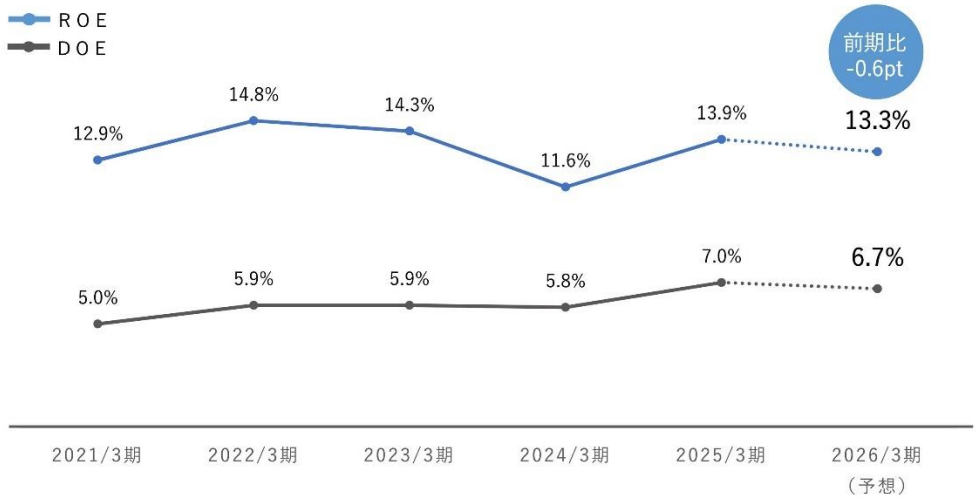


配当額と配当性向の推移です。

当期の中間配当は前回予想から 3 円増額し、37 円といたしました。2026 年 3 月期の年間配当は、現在の業績予想から、配当性向 50%とした 1 株あたり 70 円を予定しています。

ＲＯＥとＤＯＥの推移

ＲＯＥ※は13.3%と若干低下するものの、ＤＯＥ※は6.7%と目標とする5%を上回る見込み



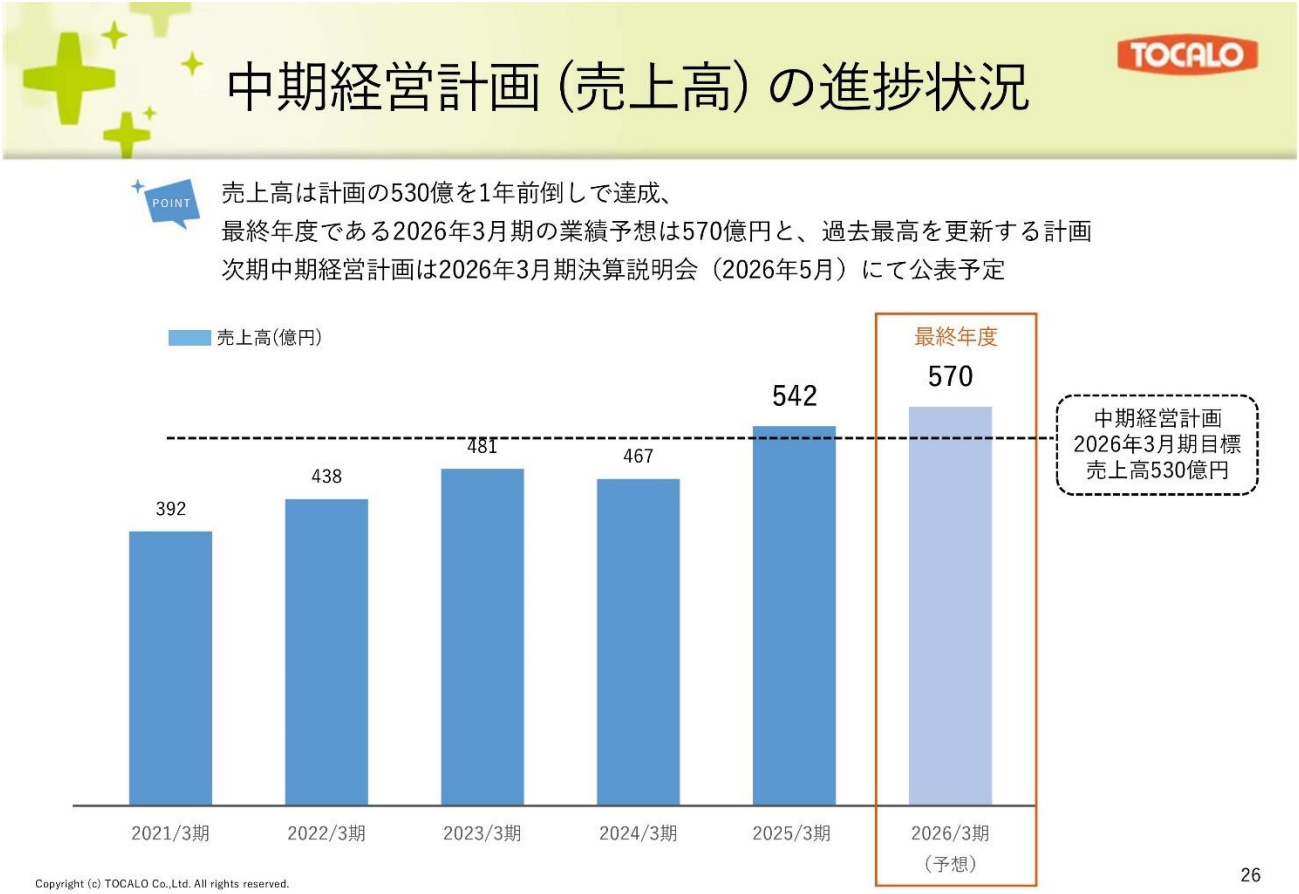
※ＲＯＥ（自己資本利益率）＝ 当期純利益／期中平均自己資本
※ＤＯＥ（純資産配当率）＝ １株当たり配当金／期中平均１株当たり純資産（＝ＲＯＥ×配当性向）

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

ROE と DOE の推移です。

2026 年 3 月期は ROE13.3%、DOE6.7%程度と見込んでいます。

サポート
日本　　050-5212-7790
フリーダイアル　　0120-966-744　メールアドレス　support@scriptsasia.com
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally



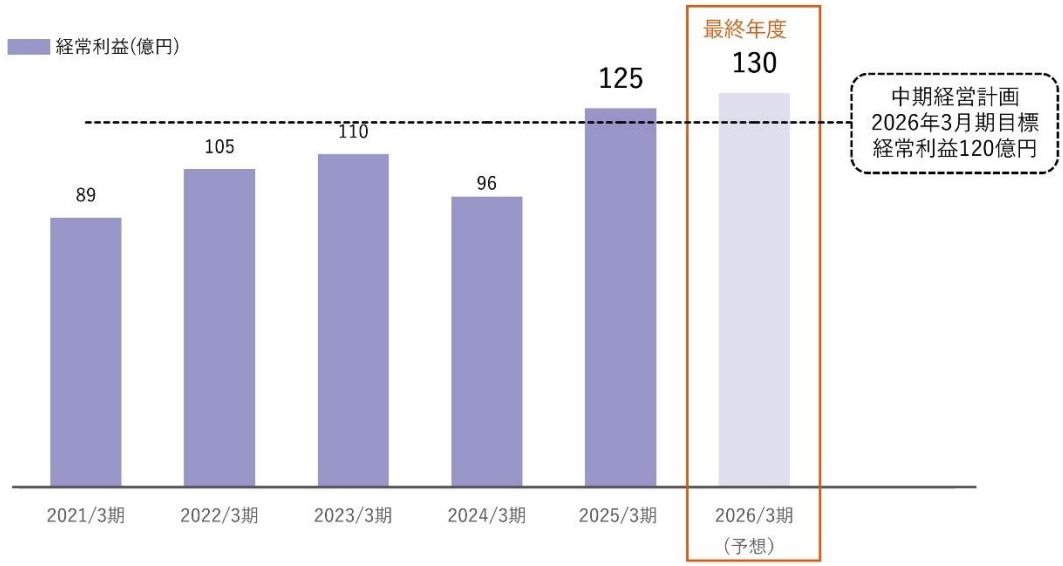
続いて、中期経営計画の進捗状況についてご説明します。

当期は 5 カ年計画の 5 年目、最終年度に当たります。中期経営計画の売上目標に対する進捗状況ですが、目標としておりました 530 億円を 1 年前倒しで達成いたしました。最終年度にあたる 2026 年 3 月期の業績予想につきましては、570 億円の過去最高を更新する計画としております。

次期中期経営計画については、2026 年 5 月の決算説明会で公表を予定しております。

中期経営計画（経常利益）の進捗状況

POINT
2026年3月期の経常利益も計画に対して1年前倒しで達成
最終年度である2026年3月期の予想は130億円と、過去最高を更新する計画



Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

27

続きまして、経常利益の進捗状況についてご説明いたします。

こちらも目標としておりました 120 億円を、1 年前倒しで達成いたしました。最終年度にあたる 2026 年 3 月期の経常利益予想につきましては、130 億円と、過去最高を更新する計画としております。

最後に、トピックスを六つご紹介します。まず、一つ目のトピックスです。

当社は、半導体・FPD 分野の生産能力強化を目的として、国内 2 拠点、海外 2 拠点において工場の建設などを進めています。

国内では、東京工場および北九州工場において、新工場棟の建設を行っており、2027 年の操業開始を予定しております。海外では台湾子会社の漢泰国際電子において、新工場が竣工いたしました。また、アメリカではトーカロ USA の子会社である TOCALO USA-Arizona をアリゾナ州に設立しました。これから工場の建設を進めて、2027 年の操業開始を予定しております。

一般産業分野の生産能力も強化

名古屋工場・グループ会社における生産体制のさらなる拡充

① 名古屋工場 新工場棟の建設

２０２５年１０月　愛知県知多市で新工場用地取得

用途目的：航空機関連の拡大に加え、産業機械・
　　鉄鋼分野での需要増加に備えた生産能力拡張
所 在 地 ：愛知県知多市（土地区画整理事業の分譲地）
敷地面積：17,033.35㎡ (5,152.55坪)
用途地域：工業地域

＜スケジュール（予定）＞
所有権移転：２０２６年４月
建設着工：２０２６年４月
工場竣工：２０２７年１０月

Copyright (c) TOCALO Co.,Ltd. All rights reserved.

② 株式会社寺田工作所 第四工場の建設

目的：生産能力拡張

＜スケジュール＞
２０２５年１０月：建設着工
２０２６年４月：工場竣工（予定）

導入設備：横型マシニングセンタ

③ TOCALO Surface Technology (Thailand)工場建設

目的：工場の移転

＜スケジュール＞
工場竣工：２０２５年７月
操業開始：２０２６年２月（予定）

30

次に、一般産業分野ですが、名古屋工場の新工場建設についてご紹介します。

まず、昨日リリースいたしましたとおり、愛知県知多市に工場用地取得の売買契約を締結しました。工場建設の目的としては、航空機関連、産業機械、鉄鋼分野の受注増に備えた生産能力拡張です。新工場の竣工および操業開始は、2027 年 10 月を予定しております。

また、昨年グループ入りした寺田工作所においても、生産能力拡大のため、敷地内に新工場の建設を進めております。2026 年 4 月に、竣工を予定しております。さらに、2024 年 6 月に完全子会社化したタイの TOCALO Surface Technology Thailand でも、工場建設を行っております。こちらは、2026 年 2 月の操業開始を予定しております。

製造プロセスの高度化

TOCALO

高精度な設備とロボットによる高度化

① 高精度光加工機の導入

＜機能皮膜の微細加工技術への進化＞
・半導体チップのさらなる微細化に対応
・精密電子部品向け金型など、幅広い分野で応用が拡大

高精度光加工機
非接触3D計測によって、1ミクロン未満の高精度加工を可能に
※1ミクロン＝1mmの1/1000（0.001mm）

トーカロの高機能皮膜 × 微細加工技術
蓄積したデータとノウハウを活用し、
高機能皮膜に加えて表面形状の微細加工を実現

② 発電所ボイラー内の出張工事のロボット化に成功

・作業員の安全性が向上
・均一で安定した皮膜の形成が可能に
・コスト削減

31

次に、製造プロセスの高度化に向けた取り組みをご紹介いたします。

まず、当社の機能皮膜の更なる進化に向けて、高精度光加工機を導入しました。この加工機により、１ミクロン未満の精度で微細加工が可能となります。当社独自のコーティング技術と微細加工技術を組み合わせることで、半導体分野の高精度部品への対応や、精密電子部品向け金型の加工など、新たなアプリケーションの拡大を図ってまいります。

次に、出張工事における溶射加工のロボット化に成功しました。従来は発電所ボイラー内で作業員が手作業で溶射を行っていましたが、この工程をロボット化することで、作業員の負担が軽減されるとともに、安全な作業環境が実現できると考えています。そして、均一で安定した皮膜の形成が可能となっていきます。今後も、更なる技術革新と生産性向上を追求してまいります。

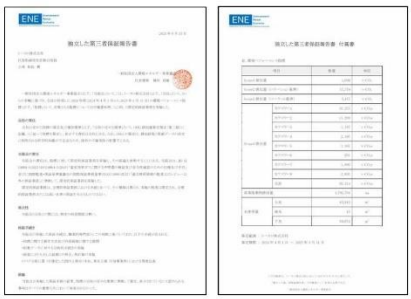
サステナビリティ①

トーカロの環境負荷低減への取り組み

＜２０４０年カーボンニュートラルに向けた検討を開始しています＞

1．全グループ会社（非連結会社を含む）で温室効果ガス排出量（Scope1、2、3）を算出

2．第三者検証の取得（トーカロ単体）
＜データの透明性と信頼性の確保＞
・温室効果ガス排出量（Scope1、2、3）
・水使用量
・産業廃棄物排出量



3．環境負荷低減に向けた取り組み（現場事例）

① 廃プラスチックリサイクル（東京工場）
＜課題＞CO_2排出係数の高い廃プラスチックの廃棄
＜対策＞マテリアルリサイクル※で廃棄物の88％を再利用
＜効果＞CO_2排出量削減

② 半導体研削工程の廃油削減（明石工場）
＜課題＞廃油が大量に発生
＜対策＞排出量を年間360tから年間18tまで95％削減
＜効果＞廃油削減による環境負荷低減

③ 水の再利用（神戸工場）
＜課題＞冷却や洗浄で大量の水を消費
＜対策＞地下タンクに貯めて洗浄槽で再利用
＜効果＞水使用量削減

※マテリアルリサイクルとは：
廃棄物を元の素材（マテリアル）として再利用する方法

32

環境負荷低減への取り組みについて、ご紹介します。

非連結会社も含め、グループ会社の温室効果ガス排出量 Scope1、2、3 の算出を完了しました。これにより、2024 年度のグループでの排出量を開示いたしました。

また、トーカロ単体においては温室効果ガス排出量、水使用量、産業廃棄物排出量の各データについて、透明性と信頼性の確保を目的として第三者検証を取得しました。

また、各事業所では、廃プラスチックのリサイクル、半導体研磨工程における廃油の削減、水の再利用など、環境負荷低減に向けた取り組みを継続的に推進しています。

詳しくは、弊社コーポレートサイトに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

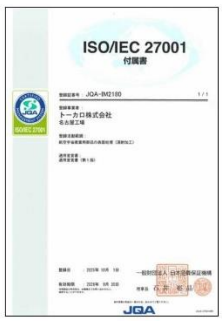
サステナビリティ②

「リスク管理」「人的資本」の強化

① 名古屋工場「ISO/IEC27001:2022」認証を取得

ISO/IEC27001:2022とは：
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格

＜概要＞
規格：ISO/IEC 27001:2022
登録番号：JQA-IM2180
審査機関：一般財団法人 日本品質保証機構（JQA）
登録組織：トーカロ株式会社 名古屋工場
活動範囲：航空宇宙産業用部品の表面処理（溶射加工）



②「プラチナくるみん」認定の取得

２０２３年に「くるみん」認定を取得し、その後も取り組みを強化した結果、くるみん認定の上位にあたる特例認定「プラチナくるみん」認定取得

「プラチナくるみん」認定とは：
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・実行し、一定の基準を満たした企業が厚生労働大臣より「くるみん認定」を受けられます。その「くるみん認定」企業のうち、さらに高い水準の取り組みを行い、一定の要件を満たした優良な企業が、特例認定である「プラチナくるみん」認定を受けることができます。

33

次に、認証取得についてご紹介いたします。

名古屋工場において、情報セキュリティマネジメントシステム ISO27001 の認証を取得しました。名古屋工場で行っている、航空宇宙産業用部品の表面処理に対する認証となります。この認証取得により、航空機分野の受注拡大に一層注力してまいります。

また、10 月には従業員の仕事と子育ての両立を支援する企業として、厚生労働大臣より、くるみん認定の上位にあたる、プラチナくるみんの認定を取得しました。今後も持続的な成長を目指し、環境ガバナンス、人的資本経営、社会貢献を始めとする ESG を継続して取り組んでまいります。

統合報告書2025発行

私たちが考える「グッド・サービス」

2025年8月29日に「統合報告書2025」を発行しました。

社長メッセージ

代表取締役
専務執行役員メッセージ

取締役 専務執行役員
管理本部長メッセージ

開発・製造・営業・工場責任者（執行役員）メッセージ

34

最後に、8 月末に発行した統合報告書 2025 についてご紹介します。

今回はトーカロ社是である「グッド・サービス」とは何かを私を始め、各役員がメッセージでお伝えしています。また、各部門の本部長による座談会や従業員のコメントなど、さまざまな視点から当社が拠り所としている考え方をご紹介しております。ぜひご覧ください。

ご説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答

司会 [M]：どうもありがとうございました。それでは、質疑応答の時間に入ります。

初めは、会場のご参加の方からの質疑応答です。オンライン参加の方は、会場での質疑応答の間に、画面の Q&A 機能にて質問をお送りいただきますようお願いいたします。

それから、この IR ミーティングは質疑応答も含めまして、全文が書き起こし対象になっております。質問の際、会社名、氏名を名乗られると、そのまま公開されます。匿名希望の方は、名乗らないでください。

それでは、お願いします。

大澤 [Q]：どうもありがとうございました。いちよし証券の大澤と申します。トピックスに関連して、大きく二つです。

1 点目が、アリゾナの新会社設立、27 年から操業というところです。場所が場所なので、特にリコート事業の取り組みは期待できると思いますし、あと装置メーカーの本国ということがありますが、例えば北九州で対応しているところと比べて、より何か具体的に出てくるメリット、スピードが速まるとか、連携が強まるとか。何か具体的な期待をお教えいただけますでしょうか。

小林 [A]：アリゾナの工場建設は、もちろんアメリカ進出の一環ということですが、顧客からの要求もかなり強くあります。顧客との連携を高めていくためにも、必然的なものだろうと思っています。

ただ、半導体景気というか半導体製造装置ビジネスは、倍増するのが 2030 年から 2032 年に 2 年ほど遅れるかもしれませんが、それに向けて生産の倍増計画を予定しています。北九州工場 1 本では生産能力が足りなくなるかもしれない。もちろん北九州工場の生産能力増強もしますが、現地であるアメリカでの生産力も高めていくことによって、メーカーとの協調性を高めていけると理解しています。

大澤 [Q]：わかりました。今のお客さんの要求というのは、装置メーカーという理解でよろしかったでしょうか。

小林 [A]：そうです。

大澤 [Q]：わかりました。あと今の 1 点目に付随して、おそらく半導体業界の米中デカップリングが出てきたのがだいたい 2000 年前後で、あれから 5 年ぐらい経ちました。

米国に現法を出すための人員体制が整ったのか。人材教育のプログラムだとか、それによってどういう人材が育ったのか、あるいは中途採用をこれまでしてきたのか、予定も含めて、どのような流れだったのでしょうか。

小林 [A]：正直、まだ完全に揃ったわけではない。ただ、3 年前から社内でグローバルチャレンジという制度を敷いて海外人員の育成に取り組んできている。われわれとしては TCA というアメリカの子会社で経験したことを、うまく引き継ぎしていきたい。アリゾナには既に送る人材を決めて、現地に派遣を開始している。

現地の従業員はまだ採用しておりませんが、当社の中で海外要員の人材育成は、順次進めています。

大澤 [Q]：わかりました。あと付随が続いて申し訳ないのですが、アメリカでの展開に際して、ロイヤリティーの問題があると思います。海外案件はロイヤリティーで対応している従来の流れと、今回の進出でバッティングはないか。あるいは今回は半導体でピンポイントなので、既存のロイヤリティーの対象先とのバッティングは生じないのか。あるいは生じた場合どのようにされていくのか。そのあたりの方針はありますでしょうか。

小林 [A]：既存の会社とのバッティングについては、今のところほぼありません。IP（知財）で区分けしているので、バッティングすることはないです。

大澤 [Q]：わかりました。2 点目、今回、名古屋で新棟建設の発表がありました。航空機や鉄鋼では、過去にも明石播磨だったと思いますが、大型案件に対応できるようになっていると思います。名古屋を拡充されたのは、5 年前か 7～8 年前にあったかと思うのですが、それ以降、お話をお聞きすることがありませんでした。

今回、名古屋工場で航空機に関する情報セキュリティ認証の話も出ていましたが、航空機がターゲットでいいのか。仮にそうだった場合、防衛予算の拡大とリンクしているのか。あるいは、そこら辺は関係ない、いわゆる民間用途とかをターゲットとしているのか。名古屋の新棟建設の趣旨を教えてください。

小林 [A]：7 年ぐらい前から、既存のお付き合いをさせていただいている会社との付き合いも、かなり進展しています。このたび、また民間航空機会社 S 社や別の会社と受注を倍増していくような

計画が立ち上がってきました。そういう民間航空機の立ち上がりに対応すること、プラス、詳しくは伏せますが、これから先のビジネスを拡大していく流れにあります。

大澤 [M]：わかりました。ありがとうございました。

司会 [M]：ありがとうございました。ほかにご質問ございますか。

質問者 [Q]：ご説明ありがとうございました。

決算発表後に株価が急落しています。それで決算を拝見したら、過去最高売上、最高利益を更新されて、中計の進捗も素晴らしい。何が起こったのかなと思って拝見していました。半導体製造関連銘柄のつれ高つれ安かと思ったら、決して御社は割高ではなくて、例えばエレクトロンとかレーザーテックとかアドテストの EBITDA を見ると、御社の 3 倍以上あり、決して高くない。株主構成を拝見したら、この辺に解があるのかなと思っているのですが。

何を申し上げたいかと言うと、株式の市場流動性が低いのではないかと思っていまして。東洋経済に言わせると、浮動株比率が 7.3%しかないと表記されていまして、東洋経済が自分の考えで計算していますが、この辺りにもしかしたら解があるのかなと思っております。

理想的な投資家比率を有していながら、市場流動性が低いので、例えば今回決算が若干下期慎重になられたことがあって、多分市場コンセンサスに届かなかったので下落したのではないかと思ってはいるのですが、それも市場流動性がもしたくさんあれば、ここまで下げなかったんじゃないかと。

質問なのですが、要は市場流動性を改善するためのあるべき株主構成とか、資本政策とか。今回中計がまた改定されますが、先々を踏まえた、あるべき資本構成、株主構成、あとは個人投資家比率だとか、こういったマーケットアビリティに関係したところで、何か今後のご方針があれば教えて欲しいです。

後藤 [A]：ご質問ありがとうございます。株主構成のことですので、管理本部長の後藤からご回答します。市場流動性が低かったのではないかというご質問ですが、確かに当社の日々の出来高が小さかったという点はあります。過去 1 年ぐらいはかなり出来高も増えてきたとは考えています。

今回の株価の急落は、おっしゃっていただいたように、コンセンサスで高い水準の予想を出していただいていたところに比べて、当社が今期の年間見通しを変えなかったことによって、逆に上期が良かった分を差し引きすると、下期が弱気なんじゃないかという反応だったと考えています。

株主構成について言えば、個人投資家が 3 割ぐらいです。あと海外投資家が 3 割ぐらい。残りは国内の機関投資家であり、一定のバランスはとれていると思います。今後はもちろん、さらに個人投資家にご支持いただけるように活動は続けていきます。株主数は順調に拡大してきているので、これまでの活動を今後も継続していく考えです。あと、株価がますます上昇していくことになれば、過去にもやっていますけども、また株式の分割等を考えてまいりたいと思っています。以上です。

質問者 [M]：ありがとうございます。株主構成比率でいうと、3 割個人ということはわかりますが、あとはその株式の稼働率について、要は抱えたまま動かさないで持っているのか。あるいは頻繁に売ったり買ったりするのか、両方稼働してくれると株価形成は変わってきます。方針は承りました。ありがとうございます。

司会 [M]：ありがとうございました。

質問者 [Q]：ご丁寧な説明、どうもありがとうございました。質問 2 点、お願いいたします。

1 点目は生産能力に関する質問で、2 点目はお答えできる範囲で来年発表される中期経営計画の質問です。

まず、生産能力に関する質問ですが、小林社長がこうした決算説明会に登場するようになって、ちょうど今日で 2 年、初めてご登壇されたときは、まだ半導体市況が少し調整局面でした。ただ、すぐ半年後には市況が回復して、小林社長様から生産能力をどうやって増やそうか考えているみたいな話と、もう一つ、トーカロという会社がもっと自動化を進めていかなければいけないというお話をされていたと記憶しています。

そこで前置きが長くなりましたが、今日の資料の 29 ページ、30 ページに、この 1 年で発表された生産能力の資料がありますが、だいたい当面の生産能力の拡張は一段落したと考えていいのか。それともまだ、もう 1 段か 2 段かわかりませんが、もう少しやはり必要だなと考えているのか。

併せて、今回発表された生産能力の評価は、どんがらというか箱の話なので、いわゆるハードの生産能力の拡大です。さっき少しお話も一部ありましたが、今度ソフトの面で、人材とこれから搬入する設備に関して、何かお話しできることがあれば、お話しいただきたい。

それと、小林社長が以前お話ししていた自動化率で、例えばですけど、今度の新しい工場に入れる設備は、従来と比べて自動化率が何%高まって、人員もこれだけ少なくて済むみたいな、例えの話をいただけると、今度新しい工場が稼働するとこんなに生産性が上がるんだというイメージができますので、お話しできる範囲で何か悦明していただけますでしょうか。小林社長の専門分野でもあると思いますので、よろしくお願いいたします。

2 点目も続けていいでしょうか。少し似たような質問で恐縮なのですが、来年春に新しい中期経営計画が出てくるとのことで、非常に期待しております。細かい数字は来年春に出てくるのを楽しみに待ちたいと思いますが、方向性、今度の中期計画で一つ何かアピールポイントがもしあればお話しいただけると、われわれの半年間の楽しみがもっと増すのかなと。例えば、量から質への転換とか、あるいは逆に、更なる量の追求とか、収益性の追求とか、何かあると非常にイメージが湧くような話をいただけると助かります。

すみません、以上 2 点です。よろしくお願いします。

小林 [A]：はい。まず生産性からお話しさせていただきます。

生産性については、当社は既に昨年、一昨年から工場の改装であったり、増築であったりは随時進めていまして、現段階で 2027 年計画としては、現行の 30%程度の増産対応ができる工場を既に準備しています。

ところが現行の話題としては、製造装置メーカーサイドで 200%の増産となる時期が、私も今までは 2030 年とずっと言い続けたのですが、どうやら 2032 年に 2 年ほど先送りされた感はあります。よって、2032 年に向けて、現行の 200%増産を目指します。日本の製造装置メーカーも大規模な工場を建てられていて、2 年先送られようと、私どもは 200%生産できなければならないと考えており準備をしていきます。東京工場でいうと、現行と同等の製造キャパを持った工場を立ち上げようと思っています。

その中身ですけれども、詳細は申し上げにくいところもあるのですが、生産性を向上させた生産設備を、今次々に認定をもらっていっています。

今の半導体業界は、CE（Copy Exactly）や CC（Change control、変更管理）を基本としています。現行の生産のやり方を変えるのは、難しさがあって、本当にじっくりじっくり行かないと変えられない。生産性が向上しますという言葉だけでは、一切変えられないという事情もあります。

ですが、実際に物を作って、生産性が改善し認定をもらったシステムがだいぶ進んできています。それを導入することで、現時点でだいたい 30%ぐらい生産効率が上がります。

ただ、コーティング部門では 30%上がるのですが、パッキングであるとか、ハンドリングには、少し時間がかかるので、全体としては 10%ぐらいしか生産効率は上がらないかもしれない。しかし設備としては 30%生産効率が上がるので、少し容積が小さくても、今のキャパと同等のキャパを作り出していけるように変わってきている。

それは北九州工場も同じで、新しいシステムを導入して、50%とか 60%とか生産性を高めた設備もありますし、30%の生産性を高めたシステムも、これから順次導入しながら生産キャパを高めていきます。

新工場棟の中に入れる装置については、やはりお客様の生産キャパが来年度どうなるかというフォーキャストに応じて、投資をしていくことになります。3 年後どうなるかを提示された状況を見ながら、設備を設置していく。ある程度、要求キャパの 30%、40%ぐらいは含みで見ながら、投資を随時進めて行く形になると思います。

まずは建物を、器を作って、今の 30%ぐらい増強するぐらいの生産を投資しておいて、そこからは随時要求に合わせていく形を取る計画にしています。

中計についてですが、基本的には、数字上は経産省の賃上げ補助金に応募しており、そこで、単体で 600 億円、トータルで 800 億円ぐらいの計画を提出しています。今の 570 億円を踏まえて 5 年後、800 億円でいいのか 900 億円にするのかを詰めながら、中計の目標数字を社内で議論しているところです。

補助金申請では、賃上げ 4%と成長性 7%を目指していくということを約束していますが、それ以上を目指して、現在、中期経営計画を立てていっています。詳しいことはまた来年発表させていただきます。

ご質問の「量なのか質なのか」という点は、われわれの中では質を高めると考えています。量を増やして売上高を伸ばしていくのではなくて、やはり今われわれが皆様にご評価いただいています利益率の高さを、今後もどのように維持していくのかを織り込みながら、中計を作り上げていこうとみんなで頑張っています。以上です。

質問者 [M]：ありがとうございました。

司会 [M]：はい、ありがとうございました。他にご質問はございますか。よろしいですか。オンラインは、ご質問は今のところ来ていないようです。

会場の方よろしいですか。それではないようですので、もし質問できなかったことや、新たな質問ございましたら、IR 担当の方にメールや電話でご連絡いただいたら、回答していただけるということですので、よろしくお願いします。

それでは以上をもちまして、本日の説明会終了です。どうも皆さん、お疲れ様でした。どうも会社の皆さん、ありがとうございました。

［了］

_____

脚注

1.　音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載

2. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す

免責事項

本資料で提供されるコンテンツの信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性等について、SCRIPTS Asia 株式会社（以下、「当社」という）は一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負いません。

本資料または当社及びデータソース先の商標、商号は、当社との個別の書面契約なしでは、いかなる投資商品（価格、リターン、パフォーマンスが、本サービスに基づいている、または連動している投資商品、例えば金融派生商品、仕組商品、投資信託、投資資産等）の情報配信・取引・販売促進・広告宣伝に関連して使用をしてはなりません。

本資料を通じて利用者に提供された情報は、投資に関するアドバイスまたは証券売買の勧誘を目的としておりません。本資料を利用した利用者による一切の行為は、すべて利用者の責任で行っていただきます。かかる利用及び行為の結果についても、利用者が責任を負うものとします。

本資料に関連して利用者が被った損害、損失、費用、並びに、本資料の提供の中断、停止、利用不能、変更及び当社による利用者の情報の削除、利用者の登録の取消し等に関連して利用者が被った損害、損失、費用につき、当社及びデータソース先は賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生的若しくは付随的損害の全てを意味します。

本資料に含まれる全ての著作権等の知的財産権は、特に明示された場合を除いて、当社に帰属します。また、本資料において特に明示された場合を除いて、事前の同意なく、これら著作物等の全部又は一部について、複製、送信、表示、実施、配布（有料・無料を問いません）、ライセンスの付与、変更、事後の使用を目的としての保存、その他の使用をすることはできません。

本資料のコンテンツは、当社によって編集されている可能性があります。